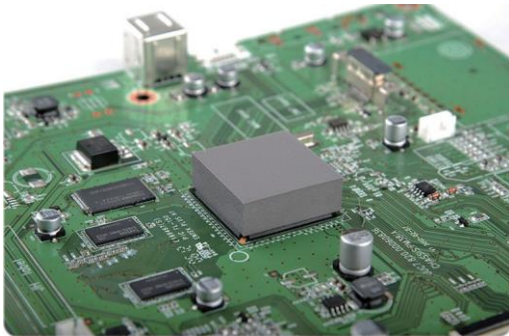


TP200 导热硅胶垫片

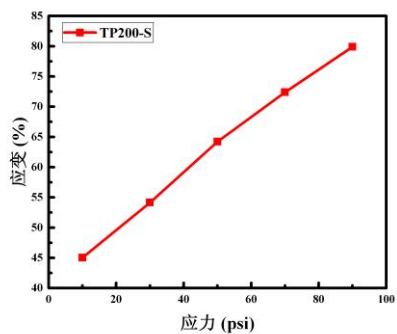
特性和优点

- 导热系数2.0W/m.K
- 低压缩力应用
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 玻纤/PI膜加强可选
- 容易装配可重复使用

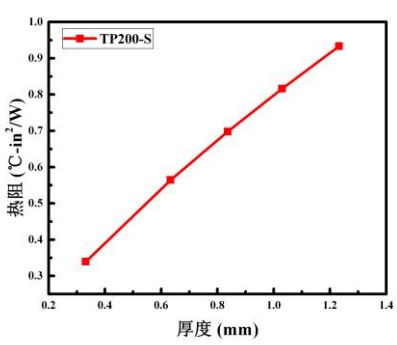


TP200导热硅胶垫片是使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成,双面自粘,低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能。在-40℃~150℃可以稳定工作,满足UL94V0的阻燃等级要求。

形变量与压力关系图



厚度与热阻性



TP200 的典型属性

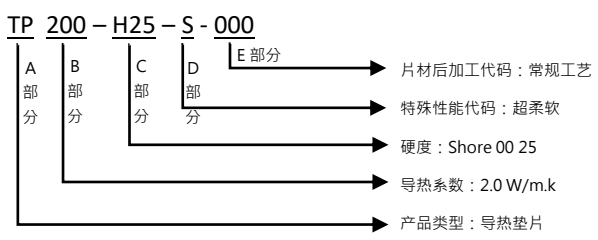
属性	公制值	测试方法
组成部分	硅胶/陶瓷	-
颜色	灰色	目视
厚度(毫米)	0.5~10.0	ASTM D374
密度 (g/cc)	2.8	ASTM D792
硬度 (Shore OO)	25	ASTM D2240
延伸率 (%)	>100	ASTM D412
长期使用温度 (°C)	-40~150	-
电性能		
击穿电压 (Kv/mm)	6.0	ASTM D149
介电常数(@10MHz)	7.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹³	ASTM D257
防火性能	V-0	UL 94
热性能		
导热系数 (W/m.K)	2.0	ASTM D5470

*厚度T≤1.0 mm,硬度H=Shore OO 35

典型应用

- 计算器散热模块
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 平面显示器
- 功率转换设备
- LED照明设备
- PDP显示屏
- LCD背光模块
- 网络通信设备
- 电源模块

产品编码规则



标准尺寸: 200x400mm. 可依客户指定模切成各种尺寸或形状。厚度按照0.25mm递增。